



半導体用ドライエッチング剤

HFC-23(CHF₃)

ドライエッチング剤 HFC-23(CHF₃)は、半導体製造向けの高純度エッチングガスです。
高圧ガスに該当します。

1. 一般物性

項目	単位	数値
分子式	—	CHF ₃
分子量	—	70.01
沸点	°C	-82
蒸気圧(25°C)	MPa	4.729

【検査項目】

純分(エア一分を除く)、異種フロン、酸分、水分、エア一分

* 個別の品質につきましては、お問合せ下さい。

2. 用途

エッチング

3. 取扱方法/安全情報

使用前に必ず SDS をお読み下さい。

保管、輸送にあたりましては、該当法規に従って下さい。

4. 梱包仕様

10L 容器、47L 容器

当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、
その安全性を保証するものではありません。

当製品を医療用途、食品用途などにお使いの場合は、弊社まで事前にご連絡下さい。

【連絡先】ダイキン工業株式会社 化学事業部

本社) 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目 4-12 梅田センタービル TEL06-6349-4344

東京) 〒108-0075 東京都港区港南二丁目 18-1 JR品川イーストビル TEL03-6716-0437

<http://www.daikin.co.jp/chm/>